

USO DE PAPEL FAX TÉRMICO (TFP) PARA EVALUAR LA PENETRACIÓN DE FLUX

¿CÓMO UTILIZAR EL TFP PARA EVALUAR LA PENETRACIÓN DE FLUX DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE FLUX POR ESPRAY?

- ★ **Antes de comenzar la prueba, realice una limpieza y servicio completo al equipo que se utilizará para la aplicación de flux**
Asegúrese de que el flux que se va a utilizar sea de un recipiente sellado y sin usar
- **Usando guantes, corte un trozo del papel fax y alinéelo con el área que será probada**
- **Use la segunda PCB con las mismas dimensiones y coloque el papel fax entre ellas**
*Si no dispone de una segunda PCB, se puede utilizar cinta Kapton pero los resultados no serán precisos
- **Colocar en los bordes de las PCBs la cinta Kapton, asegúrese de no interferir con las áreas de prueba**
*El papel fax térmico (TFP) puede ser útil para calcular la ubicación y la cantidad de flux aplicado en una PCB durante un proceso de soldadura por ola
- **Realice la prueba del ensamblaje a través del proceso de aplicación de flux**
- **Retire el ensamblaje que está en prueba de la máquina por ola, después de la aplicación del flux y antes de la etapa de precalentamiento**
- **Separe las dos tablillas y retire el papel fax de prueba**
- **Las manchas oscuras en el área de prueba son evidencia del contacto con el flux**
*Si no hay un patrón oscurecido, revise la configuración del ensamblaje de prueba para ver si está desalineado
- **Registre los ajustes en el proceso de aplicación de flux directamente en el TFP**
*Incluya el tipo de flux y el número de lote, la presión, la velocidad de desplazamiento, los cambios/tipo de boquilla y todos los demás valores que se pueden configurar

Para descargar u obtener más información visite

www.aimsolder.com



Solder plus Support